

国泰海通证券股份有限公司
关于东芯半导体股份有限公司
2024 年度持续督导年度跟踪报告

保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：东芯股份
保荐代表人姓名：张坤、陈城	被保荐公司代码：688110

重大事项提示

2024 年，公司所处的半导体设计行业景气度回升，网络通信、消费电子等下游市场需求有所回暖，公司积极把握市场机遇，加大市场拓展力度，有效推动了产品销售。公司持续布局网络通信、监控安防、消费电子、工业控制等关键应用，并逐步向汽车电子领域不断拓展，立足头部客户并不断开拓新的客户。报告期内公司实现营业收入 6.41 亿元，同比增加 20.80%；营业利润-1.69 亿元，亏损收窄 51.93%；归属于母公司所有者的净利润-1.67 亿元，亏损收窄 45.42%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-2.01 亿元，亏损收窄 38.65%。报告期内公司产品销售数量与上年同期实现较大增长，且各季度营业收入均实现环比增长。同时公司持续优化产品结构和市场策略，提升运营效率，降低产品成本，毛利率与去年同期相比有所提升。

若未来半导体行业景气度持续低迷、下游应用市场复苏不达预期、研发投入持续增加且未实现预期研发成果、效益，则公司业绩存在下滑或者亏损的风险。

经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕3558 号《关于同意东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》），东芯半导体股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“东芯股份”）首次公开发行股票 11,056.2440 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 30.18 元，募集资金总额为 333,677.44 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 306,358.16 万元。东芯股份首次公开发行证券已于 2021 年 12 月 10 日在上海证券交易所科创

板上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰海通”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日。

在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2024 年度持续督导情况报告如下：

一、2024 年保荐机构持续督导工作情况

项 目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。
2、根据上市规则规定，与公司就持续督导期间的权利义务签订持续督导协议。	保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3、协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。	保荐机构已协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。
4、持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。	保荐机构已持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
5、对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。	保荐机构已对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。
6、督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。	保荐机构已督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。
7、上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承	本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。

项 目	工作内容
诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。 保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。 上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。	上市公司或其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。
8、督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。	保荐机构已督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。
9、持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东大会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项，核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。	保荐机构已持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东大会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况。本持续督导期间，上市公司不存在应披露而未披露的重大风险或者重大负面事项。
10、重点关注上市公司是否存在如下事项： （一）存在重大财务造假嫌疑； （二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益； （三）可能存在重大违规担保； （四）资金往来或者现金流存在重大异常； （五）上交所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。 出现上述情形的，保荐机构及其保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内按规定进行专项现场核查，并在现场核查结束后 15 个工作日内披露现场核查报告。	本持续督导期内，上市公司未出现该等事项。
11、关注上市公司股票交易严重异常波动情况，督促上市公司及时按照上市规则履行信息披露义务。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
12、上市公司日常经营出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露： （一）主要业务停滞或出现可能导致主要业务	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。

项 目	工作内容
停滞的重大风险事件； （二）资产被查封、扣押或冻结； （三）未能清偿到期债务； （四）实际控制人、董事长、总经理、财务负责人或核心技术人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； （五）涉及关联交易、为他人提供担保等重大事项； （六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	
13、上市公司业务和技术出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司核心竞争力和日常经营的影响，以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露： （一）主要原材料供应或者产品销售出现重大不利变化； （二）核心技术人员离职； （三）核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可丧失、不能续期或者出现重大纠纷； （四）主要产品研发失败； （五）核心竞争力丧失竞争优势或者市场出现具有明显优势的竞争者； （六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	本持续督导期间，公司核心技术人员 KANG TAE GYOUNG 先生离职，未对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术，除此以外，上市公司及相关主体未出现其他该等事项。
14、控股股东、实际控制人及其一致行动人出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对上市公司控制权稳定和日常经营的影响、是否存在侵害上市公司利益的情形以及其他未披露重大风险发表意见并披露： （一）所持上市公司股份被司法冻结； （二）质押上市公司股份比例超过所持股份80%或者被强制平仓的； （三）上交所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
15、督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。	保荐机构已督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，持续关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。
16、持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项，对募集资金存放与使用情况进行现场检查。	保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议，于 2024 年 3

项 目	工作内容
	月 19 日、2024 年 8 月 16 日、2024 年 12 月 12 日、2025 年 4 月 17 日对上市公司募集资金存放与使用情况进行了现场检查，并出具关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
17、保荐机构发表核查意见情况。	2024 年度，保荐机构发表核查意见具体情况如下： 2024 年 1 月 6 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》； 2024 年 4 月 20 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司 2024 年度担保额度预计的核查意见》； 2024 年 4 月 20 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》； 2024 年 4 月 20 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司部分募投项目延期的的核查意见》； 2024 年 5 月 14 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告》； 2024 年 5 月 14 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告》； 2024 年 6 月 29 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》。 2024 年 7 月 11 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的核查意见》。 2024 年 8 月 24 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。 2024 年 10 月 29 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司开展外汇套期保值业务事项的核查意见》。

项 目	工作内容
	2024 年 12 月 2 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。
18、保荐机构发现的问题及整改情况（如有）	无

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

国泰海通持续督导人员对上市公司本持续督导期间的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为，上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、重大风险事项

1、公司面临的风险因素主要如下：

（1）业绩大幅下滑或亏损的风险

报告期内公司实现营业收入 64,095.35 万元，同比增长 20.80%；归属于母公司所有者的净利润-16,714.19 万元，同比增加 13,910.78 万元，亏损收窄 45.42%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-20,068.96 万元，同比增加 12,643.90 万元，亏损收窄 38.65%。报告期内，公司所处的半导体设计行业景气度回升，网络通信、消费电子等下游市场需求逐渐回暖，公司积极把握市场机遇，加大市场拓展力度，有效推动了产品销售，但受市场周期及行业竞争激烈影响，公司产品的市场价格仍处于历史相对低位，另一方面为丰富公司产品系列，公司持续保持高水平研发投入，研发费用进一步增加，导致报告期出现亏损。

若未来市场复苏不及预期，芯片去库存效果不佳以及持续的高研发投入，公司业绩存在继续下滑或亏损的风险。

（2）技术升级及产品迭代风险

公司所处的集成电路设计行业具有技术密集、产品升级迭代迅速的特点，持续的创新研发是保持竞争优势的关键。若公司未能精准把握技术趋势，或产品迭代速度滞后于行业发展及客户需求变化，将可能导致新老产品衔接不畅、收入增长动能减弱，进而削弱市场竞争力并对经营业绩产生负面影响。

（3）研发失败或产业化进展不及预期风险

集成电路设计行业技术门槛高、研发投入大、产品研发周期长，芯片产品需要经历前期的技术论证及后期的不断研发实践。研发过程较为复杂，存在不确定性，研发项目可能存在研发失败或产业化失败的风险，可能导致公司竞争力有所下降，从而影响公司后续发展。

（4）人才流失风险

集成电路设计行业属于人才密集型行业，需要相关人才具备扎实的专业知识、长期的技术沉淀和经验积累。研发团队的实力及稳定性是公司保持核心竞争力的基础，也是公司推进技术持续创新升级的关键。若公司使命、价值观及各类激励手段不足以保障现有研发团队的稳定性及持续扩充研发技术人员，将影响公司核心竞争力和持续创新能力。

（5）核心技术泄密风险

公司所处的集成电路设计行业具有技术密集性的特点，核心技术对公司提高产品质量和关键性能以及保持公司在行业内的竞争优势有着至关重要的作用，是公司核心竞争力的具体体现。

为了保证核心技术的保密性，公司针对商业保密工作制定了保密制度，明确了核心技术信息的管理流程并与核心技术人员签订了保密协议、竞业禁止协议。但由于技术秘密保护措施的限制性、技术人员的流动性及其他不可控因素，公司仍可能存在核心技术泄密的风险，将对公司研发和经营造成不利影响。

（6）委外加工及供应商集中度较高的风险

公司采用 Fabless 经营模式，公司产品生产相关环节委托晶圆代工厂、封测厂进行，晶圆代工厂及封测厂为公司的主要供应商。由于集成电路行业的特殊性，晶圆代工厂和封测厂属于重资产企业而且市场集中度较高。公司存在晶圆代工厂及封装测试厂集中度较高的风险。

未来如果晶圆价格、委外加工费用大幅上升或公司主要供应商经营发生重大变化或合作关系发生变化，导致公司供货紧张、产能受限或者采购成本增加，可能会对公司的日常经营和盈利能力造成不利影响。

（7）境外经营风险

公司推行全球化的研发设计和市场销售布局，报告期内公司的境外业务主要集中在韩国、欧洲等国家和地区。

未来如果境外各区域的市场环境、法律环境、政治环境等因素发生变化，或公司国际化运营能力不足，将对公司未来经营情况造成不利影响。

（8）业绩波动风险

宏观经济环境的波动、国家产业政策的变化、集成电路行业景气度的周期性变化、行业竞争的加剧等原因可能导致市场对公司主要产品供需关系发生变化，进而导致公司销售收入、毛利率和利润波动等风险。

（9）存货跌价风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品等构成。公司根据自身库存情况和客户的需求，并结合对市场的预测拟定采购计划。报告期末，公司存货的账面价值为 89,234.20 万元，占总资产的比例为 25.27%，占比较高。

存储芯片产品属于通用性产品，受宏观经济周期、下游终端需求、主要供应商产能等因素影响，价格呈现周期性波动。产品的市场价格去年整体呈下降趋势，报告期内产品价格有所恢复，但仍处于低位。报告期末形成存货跌价准备余额 22,899.45 万元。

如果未来公司客户需求持续低迷、市场竞争格局加剧、市场价格持续下行，或公司未能有效拓宽销售渠道，使得库存产品滞销，可能导致存货库龄变长、可变现净值降低，公司将面临存货跌价的风险。

（10）行业风险

公司为客户提供 NAND Flash、NOR Flash 及 DRAM 等存储芯片，产品覆盖了网络通信、监控安防、消费类电子、工业与医疗、汽车电子等多个领域。

受全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，集成电路行业特别是存储芯片行业存在一定的周期性，存储芯片市场与宏观经济整体亦密切相关。如果宏观经济波动较大，存储芯片的市场需求也将随之受到影响；另外下游市场需求的低迷亦会导致存储芯片的需求下降，进而影响存储芯片企业的盈利能力。宏观经济环境以及下游市场的整体波动可能对公司的经营业绩造成一定的影响。

（11）宏观环境风险

近年来国际贸易环境的不确定性增加，中美贸易摩擦不断加剧，部分国家采取激进的贸易保护措施，使得我国部分产业发展受到冲击。集成电路行业具有典型的全球化分工合作的特点，若国际贸易环境进一步恶化、各国贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续升温，则可能对公司所处的集成电路产业链产生不利影响，造成产业链上下游交易成本增加，从而可能对公司的经营带来负面影响。

四、重大违规事项

2024 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

主要财务指标的变动原因及合理性：

单位：万元

主要会计数据	2024年	2023年		本期比上年 同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	64,095.35	53,058.82	53,058.82	20.80

扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	63,934.20	52,908.83	52,908.83	20.84
归属于上市公司股东的净利润	-16,714.19	-30,624.97	-30,624.97	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,068.96	-32,712.87	-32,669.17	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-27,763.98	-30,175.59	-30,175.59	不适用
主要会计数据	2024年末	2023年末		本期末比上年同期末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	320,931.76	350,491.09	350,491.09	-8.43
总资产	353,078.10	384,716.55	384,716.55	-8.22

2024 年度，公司主要财务指标如下所示

主要财务指标	2024年	2023年		本期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益（元 / 股）	-0.38	-0.69	-0.69	不适用
稀释每股收益（元 / 股）	-0.38	-0.69	-0.69	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.46	-0.74	-0.74	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-4.99	-8.20	-8.20	增加3.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.99	-8.75	-8.75	增加2.76个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	33.27	34.34	34.34	减少1.07个百分点

本报告期公司实现营业收入 64,095.35 万元，同比增加 20.80%；扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 63,934.20 万元，同比增加 20.84%；主要系受益于半导体设计行业景气度回升，网络通信、消费电子等下游市场需求有所回暖，公司积极把握市场机遇，加大市场拓展力度，有效推动了产品销售。公司持续布局网络通信、监控安防、消费电子、工业控制等关键应用，并逐步向汽车电子领域不断拓展，立足头部客户并不断开拓新的客户。报告期内公司产品销售数量与上年同期实现较大增长，且各季度营业收入均实现环比增长。

本报告期公司归属于上市公司股东的净利润-16,714.19 万元，同比增加 13,910.78 万元，亏损收窄 45.42%，公司基本每股收益及稀释每股收益为-0.38 元，增加 0.31 元，亏损收窄 44.93%。这一积极转变主要得益于以下因素：（1）报告期内公司产品销售数量与上年同期实现较大增长；（2）毛利率上升：公司持续优

化产品结构和市场策略，提升运营效率，降低产品成本，报告期内毛利率与上年同期相比有所提升；（3）计提的存货跌价准备减少：受市场周期及行业竞争激烈影响，公司产品的市场价格仍处于历史相对低位。根据企业会计准则规定，经谨慎性考虑后，公司对存在减值迹象的存货计提跌价准备，资产减值损失同比下降。

同时，报告期内公司仍面临一定的盈利压力，主要因素如下：（1）研发费用增长：2024 年公司继续保持高水平研发投入，推动存储芯片制程升级及可靠性水平提升，并以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域布局。公司持续推进人才战略的实施，报告期内研发人员数量增加。（2）财务费用增长：受存款利率整体下行的影响，利息收入的减少所致。（3）管销费用增加：为支撑业务拓展和市场深耕，公司升级战略布局体系、拓展销售渠道，同时注重品牌建设和市场推广，管销费用随之上升。（4）2024 年下半年对外投资砺算科技（上海）有限公司，报告期内确认的投资亏损。

本报告期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,068.96 万元，同比增加 12,643.90 万元，亏损收窄 38.65%；公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.46 元，增加 0.28 元，亏损收窄 37.84%，主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加，同时非经常性损益项下的政府补助以及理财投资收益增加，这在一定程度上冲抵了归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

六、核心竞争力的变化情况

公司自成立以来就聚焦中小容量存储芯片独立研发、设计与销售，是目前中国大陆少数能够同时提供 NAND Flash、NOR Flash、DRAM 等存储芯片完整解决方案的厂商之一，产品被广泛应用于工业控制、通讯设备、安防监控、可穿戴设备和移动终端等领域。

1、不断完善的研发体系及持续的技术创新能力

公司基于研发团队多年对电路设计、工艺制造、封装测试等环节从业经历与经验，以客户需求为导向，建立了产品线短、中、长期的多层次开发计划，持续完善研究开发的系统化平台，为后续产品迅速迭代及平台工艺演进打下坚实基础。经过多年的技术积累和研发投入，公司在 NAND Flash、NOR Flash、DRAM 等

存储芯片的设计核心环节都拥有了自主研发能力与核心技术，在实际研发过程中不断积累经验，形成了多项核心技术。

2、稳定可靠的供应链体系

公司秉持“本土深度、全球广度”的供应链布局，在搭建和完善自主可控的国产化供应链体系的同时，与国内外的供应商建立了互助、互利、互信的合作关系，保证了供应链运转效率和产品质量。报告期内公司进一步优化产业链结构，加深与国际一流晶圆代工厂的合作范围与深度，公司与战略合作伙伴在高可靠性、低功耗存储芯片的特色工艺平台上开展了多年的深度技术合作，与此同时也在测试模型和测试向量上加大研发投入，提高了晶圆的产品良率和生产效率。公司与境内外知名封测厂建立了稳定的合作关系，可以为客户提供多样化的芯片封装选择。

3、完善的质量和服务体系

公司以“品质”、“竞争力”、“客户满意”、“持续改进”为公司质量方针，不断优化服务流程和运营系统，持续提升相应的产品质量与服务质量管理体系，能够为全球客户第一时间提供高效的服务支持。报告期内，公司完善了项目管理系统，实现了客户反馈的电子化管理平台，建立了车规质量管理体系，持续加强产品可靠性及生产制程的监控力度。公司建立了优秀的客户服务团队，将客户服务理念贯穿到产品研发至售后的各个环节，在内部形成良好的处理闭环，并持续提升客户服务管理能力。

4、优秀的人才队伍

集成电路设计行业属于典型的技术密集型行业，公司自成立以来就坚持以人为本、创新发展，高度重视对半导体领域尤其是研发和管理领域人才的储备和培养。通过社招、校招、内推、内部培养等多种方式，公司逐步建立了一支拥有良好人才梯队、经验丰富、底蕴深厚的技术和研发团队。截至报告期末，公司拥有研发与技术人员 202 人，占公司总人数的 63.92%，其中本科及以上学历人数占研发人员总数约 98.02%。公司的市场、运营等其他部门的核心团队均拥有行业内知名公司多年的工作经历，具有丰富的产业经验和专业的管理能力。除了不断完善的绩效考核和薪酬体系以外，公司还通过积极的股权激励计划来充分调动

员工积极性，有效促使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

5、自主清晰的知识产权

公司高度重视知识产权的自主性与完整性，经过多年持续不断的研发和创新，拥有覆盖主流存储芯片领域的多项发明专利、集成电路布图设计权、软件著作权等知识产权，相关知识产权自主完整、权属清晰。截至报告期末，公司拥有境内外有效专利 113 项、软件著作权 15 项、集成电路布图设计权 86 项、注册商标 14 项。

七、研发支出变化及研发进展

1、报告期内获得的研发成果

报告期内，申请发明专利 18 项（其中中国发明专利 15 项，美国发明专利 1 项，PCT 国际阶段发明专利申请 2 项），获得发明专利授权 30 项（其中中国发明专利 4 项，美国发明专利 4 项，韩国发明专利 22 项）；申请集成电路布图设计权 5 项，获得集成电路布图设计权 5 项；申请注册商标 4 项；申请软件著作权 1 项，获得软件著作权 1 项。截至报告期末，公司拥有境内外有效专利 113 项、软件著作权 15 项、集成电路布图设计权 86 项、注册商标 14 项。

截至报告期末，公司累计申请境内外专利 191 项，获得专利授权 113 项，专利涉及 NAND、NOR、DRAM 等存储芯片的设计核心环节，公司技术实力不断提升，报告期内获得的知识产权列表：

目	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	18	30	191	113
实用新型专利	0	0	0	0
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	1	1	15	15
其他	9	5	104	100
合计	28	36	310	228

注：1、发明专利的“累计数量”中的“申请数”包括 PCT 国际阶段发明专利申请数量；发明专利的“累计数量”中“获得数”包括曾获授权但已到期失效的发明专利，不包括已获得世界知识产权组织国际局给与国际公布的 PCT 申请数量。

2、“其他”指集成电路布图设计权与注册商标。

2、研发投入情况表

单位：元

项目	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	213,226,828.43	182,217,090.76	17.02
资本化研发投入			
研发投入合计	213,226,828.43	182,217,090.76	17.02
研发投入总额占营业收入比例（%）	33.27	34.34	减少 1.07 个百分点
研发投入资本化的比重（%）			

3、在研项目情况

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	1xnm NAND Flash 系列产品	19,940.00	2,528.25	9,515.54	风险量产阶段	研发更先进制程的 SLC NAND Flash 芯片	国际领先	网络通信、监控安防、消费类电子、工业控制等领域
2	2xnm NAND Flash 系列产品	8,800.00	2,387.91	9,410.37	部分产品已量产	扩充 SLC NAND Flash 产品丰富度，提升产品可靠性	国内领先	网络通信、监控安防、消费类电子、工业控制等领域
3	28nm NAND Flash 系列产品	14,000.00	1,754.29	11,242.55	部分产品已量产	扩充 SLC NAND Flash 产品丰富度，提升产品可靠性	国内领先	网络通信、监控安防、消费类电子、工业控制、汽车电子等领域
4	48nm NOR Flash 系列产品	10,000.00	1,467.60	8,935.56	部分产品已量产	研发更低成本、更高性能的 NOR Flash 芯片	国际领先	网络通信、监控安防、消费类电子、工业控制、汽车电子等领域
5	55nm NOR Flash 系列产品	8,000.00	1,049.17	5,069.43	部分产品已量产	扩充 NOR Flash 产品丰富度，提升产品可靠性	国内先进	网络通信、监控安防、消费类电子、工业控制、汽车电子等领域
6	DDR3 系列产品	2,350.00	1,061.11	1,061.11	部分产品已量产	扩充 DRAM 产品线	国内先进	网络通信、监控安防、消费类电

								子、工业控制等领域
7	LPDDR4x系列产品	8,930.00	1,656.42	3,507.02	量产阶段	研发第四代低功耗 DDR 产品，实现 LPDDR 系列产品升级迭代	国内领先	网络通信、消费电子、工业控制、汽车电子等领域
8	其他 DRAM 产品	8,500.00	1,504.45	6,049.32	部分产品已量产	对现有 DRAM 产品进行持续升级	国内先进	网络通信、监控安防、消费类电子、工业控制等领域
9	车规产品	14,273.88	3,963.40	9,272.34	部分产品已通过 AEC-Q100 验证，已实现车规产品销售	符合 AEC 国际车规认证标准，并符合车规客户要求	国内领先	车载类应用等领域
10	WIFI 7 产品	20,000.00	3,950.08	3,950.08	研发阶段	研发中高端 Wi-Fi 透传芯片，丰富公司产品线	国内先进	家庭娱乐终端、物联网等领域
合计	/	114,793.88	21,322.68	68,013.32	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

截至 2024 年 12 月 31 日，发行人募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	序号	金额
实际募集资金到位金额	A	308,581.64
减：审计验资费、律师费等发行费用	B	2,223.48
募集资金净额	C=A-B	306,358.16
期初实际结余募集资金余额	D	72,655.77
加：赎回现金管理金额	E	131,500.00
现金管理收益、利息收入扣减手续费净额	F	1,818.27

减：募集项目支出	G	11,202.16
部分项目结余永久补充流动资金	H	5,699.24
募集资金置换	I	-
支付审计验资费、律师费等发行费用	J	-
补充流动资金转出	K	-
使用募集资金进行现金管理	L	172,500.00
使用募集资金进行股份回购	M	13,547.05
结余募集资金余额	$N=D+E+F-G-H-I-J-K-L-M$	3,025.59
实际结余募集资金余额	O	3,025.59
差异	$P=N-O$	-

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 10.00 亿元。

公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员存在减持情况如下：

单位：股

序号	姓名	职务	年初直接持股数量	2024 年末直接持股数量	本期减持数量
1	谢莺霞	董事、总经理	750,000	562,500	187,500

除上述情况外，截至 2024 年 12 月 31 日，东芯股份控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有东芯股份的股份均不存在质押、冻结及减持

的情形。

十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

经核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项。

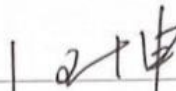
十二、其他说明

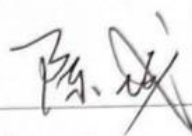
本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、年度报告等信息披露文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司
2024 年度持续督导年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：


张 坤


陈 城



2025年4月30日